

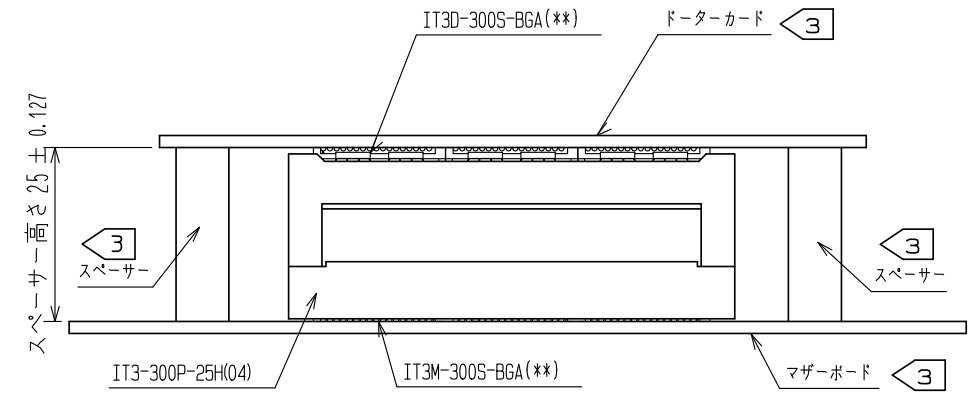
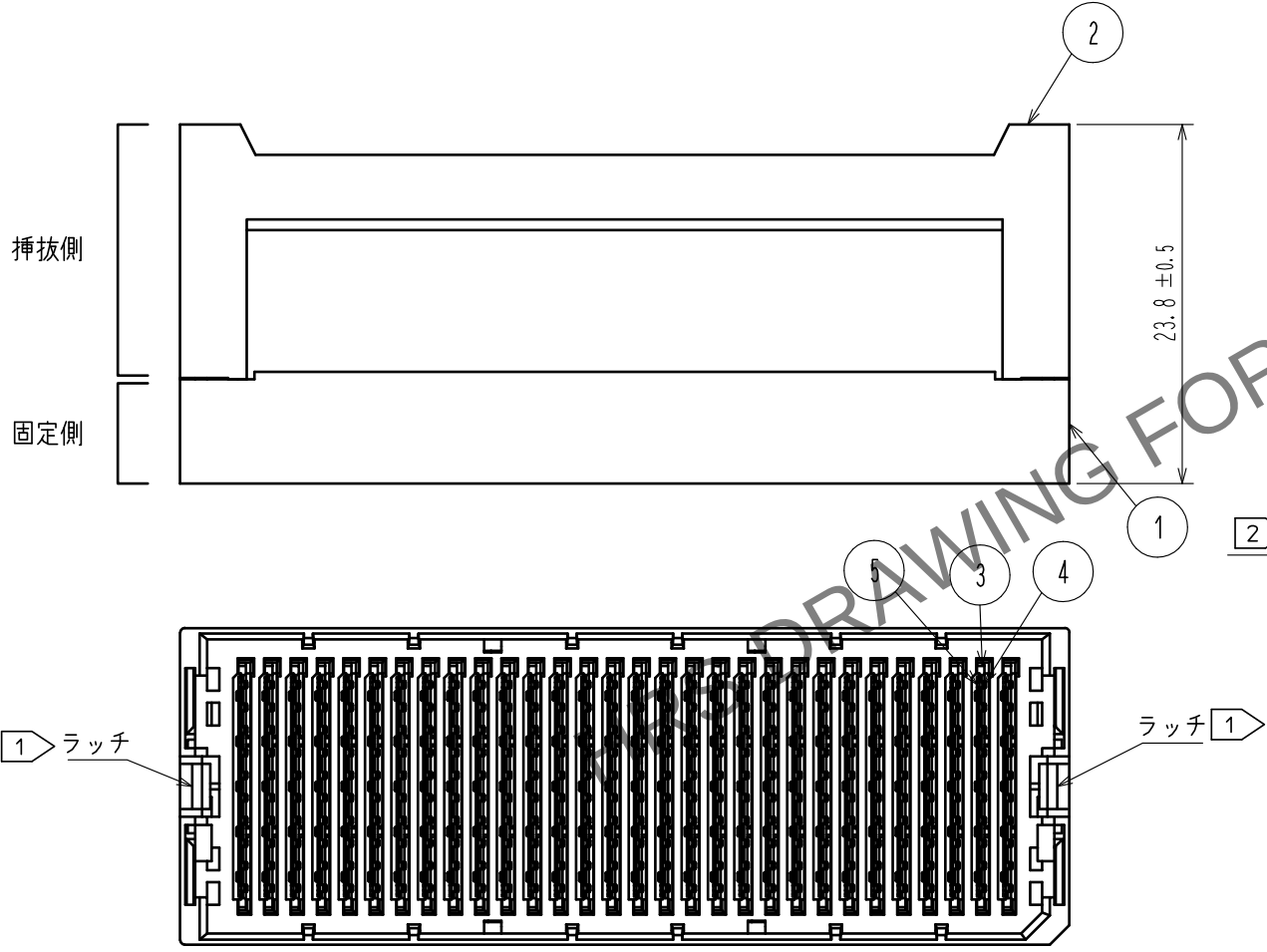
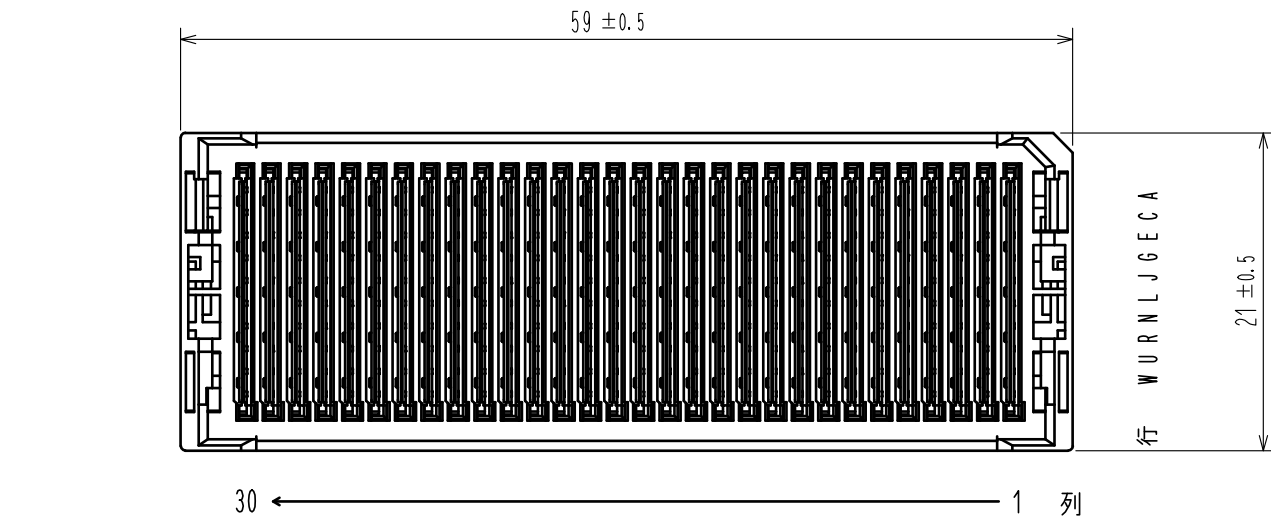
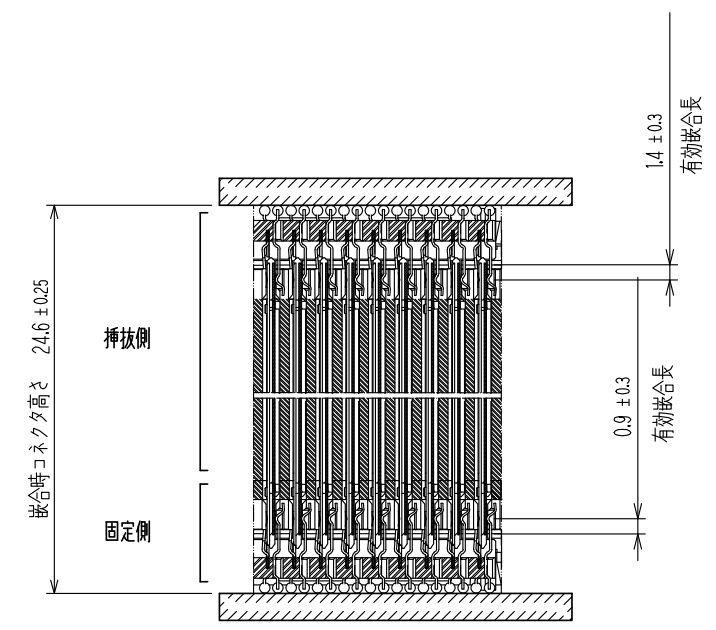


Fig. 1(FREE)



嵌合断面図 (FREE)

- 注.  1 固定側は、レセプタクル: IT3M-300S-BGA(**)と嵌合し、
ラッチにて固定されます。
-  2 ロットNo. は、図示の位置に示すものとします。
-  3 IT3*-300S-BGA(**)のはんだ結合部に対するストレスを防ぐため、
マザーボードとドーターカード間に金属のスペーサーを挟み、
固定するものとします。
4. 取扱情報等の詳細につきましては、本製品の取り扱い方法の
ETAD-F0347 “IT3 デザインガイドライン” を参照下さい。
5. 本製品は、信号 300 芯とグランド 270 芯の構成となります。
6. 本製品は、1トレーに 30 個入りとなります。
7. 本製品は、1ダンボールに60個入りが標準梱包となります。

[illegible]